

I 事業報告 総括

2024年度は、国内外における産業環境の変化や半導体関連分野への注目が一層高まる中での事業推進となり、会員各位の継続的なご理解とご協力、そして事業への積極的なご参画により、年間を通じて計画的な事業運営を行うことができた。また、企画委員会が中心となって実効性の高い事業計画を策定し、イノベーション・マーケティング・ネットワークの各専門部会がそれぞれの分野において主体的に取り組んだ結果、地域の技術力強化や新たなビジネス機会の創出、産学官の連携深化といった多面的な成果が得られた。

主な事業は次のとおりである。

- 研究開発事業では、ニッチトップ・ニューマーケット推進事業として公募。これまで培ってきた自社の強みを活かし、自社にとっての新分野への事業展開や、自社の強みを更に高めるための製品競争力の強化を目的とした開発事業に対して、支援を実施した。
- 人材育成事業では、継続開催している半導体基礎講座を技術基盤として実施した。また、新分野・成長分野参入に直結した技術力を習得できるよう、首都圏開催の系統的な技術研修会を大分にて開催し、当会員の技術力の向上をはかった。リスキリングとして、企画力を高めるために事業創出セミナーを継続した。
- 販路開拓・情報提供事業では、アジア最大級展示博覧会であるセミコンジャパン・ネプコンジャパンに出展し、当会員の紹介及び当会PRを行った。また、TEEIA・熊本県と連携し、台湾企業との商談会を開催した。
- 会員交流事業では、トップセミナーを開催し、経営へ寄与する半導体産業動向の情報提供とともに、会員相互の交流によるネットワークの強化を図った。また、会員交流会では交流活性化はもとより、九州・大分の半導体産業の未来についてセミナーを開催した。
- 総会では、あわせてフォーラムを開催し、2022年熊本県に進出したjasmの進捗と展望について、またイノベーション戦略による半導体市場の動向についてのご講演により、会員の知見を深めることができた。
- 2019年度発行した、『災害時における相互協力に関する合意書』については、合意書会員拡大の継続的呼び掛けとともに、BCP連携に繋げる施策の検討を行った。
又、いわて半導体関連産業集積促進協議会(I-SEP)、みえ半導体ネットワークとの合意書を交付した。

II 事業報告

1. 理事会・専門部会等の開催

「おおいたLSIクラスター中期ビジョン」の実現に向けた事業計画等を協議し推進するため、理事会、企画委員会と、イノベーション・マーケティング・ネットワークの3つの専門部会及びニッチトップ・ニューマーケット推進事業の審査会を開催した。

(1) 理事会

①第1回理事会

日 時：2024年5月23日(水) 14:00～15:30

場 所：大分県産業科学技術センター 多目的ホール

議 題：・新任理事、監事交替に伴う挨拶

・2023年度事業報告

・2023年度収支決算報告

・2024年度事業計画 ほか

②第2回理事会

日 時：2025年3月12日(水) 14:00～15:30

場 所：大分県産業科学技術センター 多目的ホール

議 題：・2024年度収支予算の補正について

・2025年度事業計画及び収支予算

・2024年度事業進捗状況報告 ほか

(2) 企画委員会

①第1回企画委員会

日 時：2024年4月25日(木) 14:00～17:00

場 所：大分県庁舎 本館 12会議室

②第2回企画委員会

日 時：2024年6月18日(木) 15:30～17:00

場 所：大分県庁舎 別館 B11会議室

③第3回企画委員会

日 時：2024年8月21日(水) 15:00～17:30

場 所：大分県庁舎 本館 82会議室

④第4回企画委員会

日 時：2024年10月15日(火) 15:30～17:45

場 所：大分県庁舎 本館 防災活動支援室2

⑤第5回企画委員会

日 時：2024年12月19日(木) 14:30～16:00

場 所：大分県庁舎 本館 防災活動支援室2

⑥第6回企画委員会

日 時：2025年2月27日(木) 15:30～17:30

場 所：大分県庁舎 本館 12会議室

(3) 専門部会

[イノベーション部会]

① 日 時：2024年5月29日(金) 15:00～16:00

場 所：大分県産業科学技術センター 第2研修室

② 日 時：2024年11月19日(火) 15:30～17:00

場 所：大分県庁舎 本館 101会議室

③ 日 時：2025年2月18日(火) 15:00～16:00

場 所：大分県産業科学技術センター 第1研修室

[マーケティング部会]

① 日 時：2024年6月11日(木) 15:00～16:00

場 所：大分県庁 別館 B-11会議室

② 日 時：2024年11月26日(火) 15:00～16:00

場 所：大分県産業科学技術センター 第1研修室

③ 日 時：2025年2月19日(水) 15:00～16:00

場 所：大分県産業科学技術センター 第2研修室

[ネットワーク部会]

- ① 日 時：2024年6月3日(月) 15:00～16:00
場 所：大分県産業科学技術センター 第1研修室
- ② 日 時：2024年11月21日(木) 15:00～16:00
場 所：大分県産業科学技術センター 第1研修室
- ③ 日 時：2025年2月12日(水) 15:00～16:00
場 所：大分県産業科学技術センター 第1研修室

(4) ニッチトップ・ニューマーケット推進事業審査会／成果報告会

- ① 日 時：2024年6月5日(水) 13:30～17:00
場 所：(発表者) 大分県産業科学技術センター 第2研修室
(審査員) オンライン
- ② 日 時：2025年3月5日(火) 13:30～16:30
場 所：(発表者) 大分県産業科学技術センター 第1研修室
(審査員) 対面

2. 総会・フォーラムの開催

日 時：2024年7月3日(月) 14:00～17:50

場 所：レンブラントホテル大分

参加者：183名(73団体)

内 容：①主催者挨拶 大分県知事

佐藤 樹一郎

大分県LSIクラスター形成推進会議 会長 川越 洋規

②来賓紹介及び挨拶

九州経済産業局 局長

星野 光明 氏

(一社)九州半導体・デジタルイノベーション協議会 会長 山口 宜洋 氏

③「おおいたLSIクラスター」事業報告

大分県LSIクラスター形成推進会議 企画委員長

大分県LSIクラスター形成推進会議 各専門部会長

④基調講演

『JASMの進捗と今後の展望』

講師 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社

取締役社長

堀田 祐一 氏

⑤特別講演

『世界の半導体市場動向と日本の国際競争力』

～AI、DX/GXがこれまでの半導体需要に変化を与える～

講師 インフォマインテリジェンス合同会社

シニア コンサルティング ディレクター 南川 明 氏

3. イノベーション事業の実施

(1) ニッチトップ・ニューマーケット推進事業

これまで培ってきた自社の強みをいかし、自社にとって新分野への事業展開(ニューマーケット進出事業)や、自社の強みを更に高めるための製品競争力の強化(ニッチトップ創出事業)を目的とした開発事業に対して補助金を交付した。

成果報告会を開催し、各事業の成果を確認するとともに、より効果的な事業とするためアドバイスを行った。また、過去の採択案件についても適宜サポートを行った。

・ニューマーケット進出事業

①半導体向け磁気シールドルーム ビジネスに関わる事業体制の構築

②ウェハーダイシング／ダイボンディング／ワイヤーボンディングプロセス開発によるニューマーケットへの進出

- ③IoT を活用した林業従事者向け携帯型危険回避機器開発
- ・ニッチトップ創出事業
 - ①バーンイン装置用大電流電源基板開発

(2) 先端技術力の向上及び中堅社員のスキルアップ

1) 事業創出セミナー

全2回の教育を通じて、人を巻き込みながら各社における新規事業を創出するカリキュラムの提供と実践支援を行った。

・開催日時：

7月23日(火)、8月1日(木) 9:30～16:30

参加者：10社(23名)

2) 技術者研修会

ビジネスチャンス獲得に向け、半導体の最新技術や新たな成長分野をテーマにした技術者研修会(技術者塾)を開催した。

①技術者塾Ⅰ

テーマ：品質不具合を未然に防ぐ切り札“DRBFM

日時：2024年7月26日(金) 9:30～16:30

場所：大分県産業科学技術センター 多目的ホール

講師：ワールドテック代表取締役

寺倉 修 氏

参加者：15企業 44名(大分県自動車関連企業会と共催)

②技術者塾Ⅱ

テーマ：なぜなぜ分析 演習付きセミナー実践編

日時：2024年12月16日(月) 9:30～16:30

場所：大分県産業科学技術センター 多目的ホール

講師：マネジメント・ダイナミクス社長、中小企業診断士

小倉 仁志 氏

参加者：26企業 50名(自動車関連企業会と共催)

③技術者塾Ⅲ

テーマ：データ分析活用入門

日時：2025年1月28日(火) 13:00～17:00

方式：オンライン講座

講師：データ&ストーリーLLC 代表、多摩大学大学院 MBA 客員教授

柏木 吉基 氏

参加者：21企業 106名

3) 技術セミナー

①デジタル回路設計講座

目的：ハードウェア記述言語(HDL: Hardware Description Language)を用いたデジタル回路設計の技術を身につける

日時：2024年8月22日(木)、27日(火) 9:30～16:30

場所：大分工業高等専門学校

講師：情報工学科 講師 井上 優良 氏

参加者：1企業 5名

②アナログ回路設計講座

目的：デジタル製品設計におけるアナログ回路知識の重要性と、代表例であるオペアンプを題材とした技術の習得する。

日時：2024年9月3日(火) 13:30～14:50

場所：大分県産業科学技術センター 第1研修室

講師：株式会社日出ハイテック 回路設計エンジニア 錦戸 大樹 氏

田口 幸一 氏

西水 学 氏

首藤 祐志 氏

参加者：5企業 12名

③パワーデバイス基礎講座

テーマ：自動車電動化に向けたパワーデバイス開発の最新状況と今後の動向把握
日 時：2024年9月12日(木) 10:00～15:00
場 所：大分県産業科学技術センター 多目的ホール
講 師：筑波大学数理物質系 物理工学域 教授 岩室 憲幸 氏
参加者：16企業 54名(大分県自動車関連企業会と共催)

(3) 基礎教育・新人教育の充実

1) 半導体基礎講座

会員企業の新任技術者等を対象にした半導体基礎講座を、(株)エリアへ業務委託により実施した(コース3回)。又、会員協力により工場見学を開催。

日 時：2024年6月13日(木)、18日(火)、27日(木) 9:00～17:00

場 所：大分県産業科学技術センター 第1研修室

講 師：13日 大分大学理工学部電気電子コース 准教授 大森 雅登 氏

18日・27日 (元)T I /ソニーエンジニア

(現)大手半導体関連企業 菊池 保夫 氏

企業見学：ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)

大分電子工業(株)三重工場

ルネサスエレクトロニクス(株)大分工場

受講者：13日－16社 54名、18日－17社 52名

27日－15社 44名

2) 人材養成補助金

会員企業の事業計画に沿った専門人材の育成を目的に通信講座を活用する企業に授業料の補助を行った。

結 果：14社 45名

(4) 「学」との連携・広域連携

1) 大学・高専連携推進補助事業

産学連携強化を目的に大分大学・大分高専との卒論テーマ・教職員共同テーマを会員企業課題として、共同研究を実施、その研究費の補助を行った。

■大分高専

①パワーモジュールの寄生インダクタンス設計検証

②半導体製造プロセス効率化に向けたデータ分析

4. マーケティング事業の実施

(1) 海外ビジネス交流事業

今年度も台湾電子設備協会(T E E I A)、熊本県工業連合会と連携して、対面での台湾商談会を開催し、大分県(延べ)：21社、84商談実施。

① 台湾との交流－1

商談会(大分会場)

開催日：2024年4月18日(木)

場 所：レンブラントホテル大分

参加企業：大分L S I 10社、熊本県工連 13社、台湾企業 16社

※大分 計27商談

②台湾との交流－2

商談会(台北会場)

開催日：2024年9月3日(火)

場 所：ホテルイリュウム台北

参加企業：大分LSI 11社、SIIQ会員 2社、熊本県工連 11社
台湾企業 35社
※大分 計57商談

(2) 展示会への出展

①セミコンジャパン2024

半導体関連国際展示会である「セミコンジャパン2024」に、長崎県・福岡県と合同で九州パビリオンとして出展した。九州パビリオンの中で会員企業9社と「クラスターブース」を形成し、「おおいたLSIクラスター」の会員企業の新技術・新製品等の情報を発信した。あわせて企業立地課ブースを設け、大分県企業誘致を推進した。

開催日：2024年12月11日(水)～13日(金)

場 所：東京ビッグサイト 東ホール

総小間数：36小間

出展内容：クラスターブースを会員9社がパネル・サンプル展示で活用。

さらに、クラスターパンフレット、会員パンフレット 各配布

商談案件：基板修理、ウェーハ加工、エッチング液の共同開発、希少金属加工

産業用ICのテストターンキー委託、部材メーカー立地案件 等

②ネプコンジャパン2025

エレクトロニクス開発・製造・検査に関するアジア最大級の専門展である「ネプコンジャパン」に出展した。今年度は会員企業8社と合同で九州パビリオンとして出展、当会活動状況を紹介した。

開催日：2025年1月22日(水)～24日(金)

場 所：東京ビッグサイト 東ホール

出展小間数：1.5小間

出展内容：クラスターブースを会員8社がパネル・サンプル展示で活用。

さらに、クラスターパンフレット、会員パンフレット 各配布

商談案件：ウェーハ加工、金属部品加工、テスト開発委託、後工程委託 等

(3) みえ半導体ネットワークとの連携協定締結

①人材・技術交流、共同商談会による取引拡大、災害時BCP活動での連携。半導体産業の動向や関連施策の情報共有での連携。

日時：2024年7月12日(金)

場所：三重県庁講堂

参加団体：LSIクラスター形成推進会議、いわて半導体関連産業集積促進協議会、
みえ半導体ネットワーク

(4) いわて半導体関連産業集積促進協議会との交流

①同協議会の会員企業を視察し、更なる交流を図った。

日 時：2024年7月31日(水)～8月1日(木)

訪問先：3社

参加者：9名(4社、2機関)

5. ネットワーク事業の実施

(1) トップセミナー

会員企業の経営責任者等を対象として、さらなる資質の向上とネットワークの拡大を図ることを目的にトップセミナーを開催した。

①日 時：2024年5月13日(月)15:30～17:00

場 所：レンブラントホテル大分 2階 二豊の間

方 式：対面開催

演 題：「『AI 活用による業務効率化と企業変革の推進
～AI の利活用状況と課題解決に向けた方向性について～」
講 師：ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
法人サービス事業部 データサイエンティスト 松原 雅信 氏

参加者：81名（34団体）

②日 時：2024年9月24日(火) 15:30～17:00

場 所：ホテル日航 大分オアシスタワー 5階 孔雀の間

方 式：対面開催

演 題：「半導体と九州の未来」

講 師：公立大学法人 熊本県立大学 理事長 黒田 忠広 氏

参加者：89名（32団体）

③日 時：2025年2月20日(木) 15:30～17:00

場 所：レンブラントホテル大分 2階 二豊の間

方 式：対面開催

演 題：「半導体による国起こしの時代が到来、主役は九州シリコンアイランド
～熊本、福岡、大分、長崎などで設備投資が一気に加速する！～」

講 師：株式会社産業タイムズ社 代表取締役 会長 泉谷 渉 氏

参加者：112名（46団体）

（２）会員間及び産学官のネットワークづくり

①会員交流会の開催

日 時：2024年11月29日(金) 15:30～17:00

場 所：レンブラントホテル大分 2階 二豊の間

演 題：『シリコンアイランド九州の未来
～大分県の半導体関連産業の課題と期待・チャンス～』

講 師：(公財)常務理事兼事業開発部長 岡野 秀之 氏

参加者：74名（30団体）

②おおいたテクノピッチの開催

大分県工業連合会と共催で、県内製造業の将来を担う人材確保につなげるため、県内企業が持つ優れた技術やものづくり産業の魅力を工業系学生に直接アピールする交流イベント「おおいたテクノピッチ」を開催した。

第1回目

日 時：2024年7月17日(水) 14:50～17:50

場 所：大分大学

参加企業：10社（内 当会会員5社）

株式会社ジャパンセミコンダクター・株式会社エリア

ソニーセミコンダクターマニュファクチャリング株式会社

株式会社AKシステム・柳井電機 株式会社

参加者：機械工学プログラム、智能機械システムプログラム：96名（1年生）

第2回目

日 時：2024年10月30日(水) 13:30～15:50

場 所：大分工業高等専門学校

参加企業：9社（内 当会会員7社）

株式会社戸高製作所、エスティケイテクノロジー株式会社、

株式会社アーネット、大分デバイステクノロジー株式会社、

ルネサスエレクトロニクス株式会社 大分工場

株式会社日本マイクロニクス、テクノプローブ・ジャパン株式会社

参加者：機械工学科、電気電子工学科：87名（4年生）

第3回目

日 時：2024年11月6日(水) 13:00～16:50

場 所：大分県立工科短期大学校

参加企業：14社（内 当会会員12社）

（株）ジャパンセミコンダクター、ルネサスエレクトロニクス（株）、
ソニーセミコンダクターマニュファクチャリング（株）、（株）エリア
大分デバイステクノロジー（株）、（株）日本マイクロニクス、
（株）デンケン、（株）佐々木精工、（株）戸高製作所、（株）AKシステム、
エスティケイテクノロジー（株）、TOTOファインセラミックス（株）

参加者：機械工学科、電気電子工学科：35名（1年生）

第4回目

日 時：2024年11月14日（木）13：00～14：30

場 所：日本文理大学

参加企業：8社（内 当会会員2社）

テクノプローブジャパン（株）、（株）アーネット

参加者：機械工学科、電気電子工学科：55名（1年生）

③おおいた“産”観日の開催

大分県工業連合会と共催で、県内製造業の将来を担う人材確保につなげるため、県内企業が持つ優れた技術やものづくり産業の魅力を工業系学生に直接アピールする会社見学会「おおいた“産”観日」を開催した。

第1回目

日 時：2024年9月30日（月）8：30～17：00

概 要：県内各企業

参加企業：12社（内 当会会員8社）

（株）AKシステム、（株）デンケン、（株）エリア、柳井電機工業（株）、
テクノプローブジャパン（株）、エスティケイテクノロジー（株）、
ソニーセミコンダクターマニュファクチャリング（株）、
大分電子工業（株）

参加者：大分大学 機械工学プログラム 3年生 69名

第2回目

日 時：2024年11月20日（水）10：00～16：00

概 要：県内各企業

参加企業：8社（内 当会会員5社）

エスティケイテクノロジー（株）、（株）佐々木精工、大分電子工業（株）、
（株）デンケン、（株）エリア

参加者：大分県立工科短期大学校 1年生

機械コース：21名、電気・電子コース：17名、建築コース：14名

（3）『災害時における相互協力に関する合意書』 登録会員拡大

概 要：災害時において会員の相互協力によって製品供給の継続に努め、顧客ひいては社会の発展に貢献できるよう参加会員にて合意した。

発行日：2025年3月12日（2019年2月27日（水）初版）

合意会員：27社

補 足：いわて半導体関連産業集積促進協議会（I-SEP）、みえ半導体ネットワークとの合意書交付を、各々2024年2月22日、7月12日に実施。

第2号議案

2024年度収支決算報告書

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

収入の部

(単位:円)

科 目	現計予算額 ①	決算額 ②	増減額 ②-①	備 考
1 負担金収入	44,367,000	44,367,000	0	大分県負担金
2 事業収入	250,000	250,000	0	
3 会費収入	1,090,000	1,090,000	0	109社 * 10,000円
4 雑収入	13,000	13,801	801	預金利息等
当期収入合計(A)	45,720,000	45,720,801	801	
前 期 繰 越 金	4,203,000	4,203,072	72	
収 入 総 合 計(B)	49,923,000	49,923,873	873	

支出の部

(単位:円)

科 目	現計予算額 ①	決算額 ②	増減額 ①-②	備 考
1 理事会・専門部会等開催費	412,000	297,755	114,245	
理事会運営費	119,000	50,565	68,435	2回開催
報酬	62,000	24,900	37,100	
旅費	54,000	23,265	30,735	
食糧費	3,000	2,400	600	
専門部会・審査会等運営費	293,000	247,190	45,810	
報酬	238,000	199,200	38,800	
旅費	33,000	26,370	6,630	
食糧費	22,000	21,620	380	
2 総会・フォーラム開催費	1,411,000	1,306,856	104,144	
総会運営費	1,246,000	1,142,134	103,866	
旅費	170,000	75,600	94,400	
食糧費	402,000	393,994	8,006	
印刷消耗費	159,000	158,400	600	
委託料	55,000	55,000	0	
使用料及び賃借料	460,000	459,140	860	
フォーラム開催費	165,000	164,722	278	
報償費	50,000	50,000	0	
旅費	115,000	114,722	278	
3 イノベーション事業費	15,423,000	15,058,713	364,287	
研究開発・調査研究事業費	10,600,000	10,600,000	0	
負担金補助及び交付金	10,600,000	10,600,000	0	
半導体技術者基礎講座費	934,000	933,108	892	
委託料	934,000	933,108	892	
技術者研修会費	1,222,000	1,059,805	162,195	
報償費	396,000	395,280	720	
委託料	800,000	639,325	160,675	自動車関連企業会との共催等による減
使用料及び賃借料	26,000	25,200	800	
人材養成費	1,157,000	1,056,000	101,000	
報償費	119,000	118,800	200	
委託料	1,038,000	937,200	100,800	技術人材養成事業の受講単価に伴う減
新分野・成長分野参入促進費	1,510,000	1,409,800	100,200	
報償費	245,000	244,800	200	
委託料	1,265,000	1,165,000	100,000	自動車関連企業会との共催等による減

科 目	現計予算額 ①	決算額 ②	増減額 ①－②	備 考
4 マーケティング事業費	13,187,000	12,621,311	565,689	
海外ビジネス交流事業費	2,960,000	2,956,854	3,146	
報償費	25,000	24,278	722	
旅費	1,074,000	1,073,501	499	
食糧費	177,000	176,885	115	
印刷消耗費	177,000	176,436	564	
通信運搬費	20,000	19,432	568	
委託料	889,000	888,572	428	
使用料及び賃借料	278,000	277,750	250	
負担金補助及び交付金	320,000	320,000	0	
販路開拓調査事業費	1,808,000	1,647,402	160,598	
報償費	25,000	24,346	654	
旅費	1,348,000	1,188,796	159,204	
食糧費	125,000	124,500	500	
使用料及び賃借料	310,000	309,760	240	
展示会出展事業費	8,019,000	7,817,055	201,945	
旅費	389,000	388,920	80	
印刷消耗費	411,000	410,960	40	
通信運搬費	269,000	268,620	380	
委託料	2,011,000	2,010,305	695	
使用料及び賃借料	4,939,000	4,738,250	200,750	展示小間料の減
販路開拓・拡大補助事業費	400,000	200,000	200,000	
負担金補助及び交付金	400,000	200,000	200,000	説明員派遣費用費補助実績に伴う減(10社→5社)
5 ネットワーク事業費	2,538,000	2,090,475	447,525	
トップセミナー費	1,797,000	1,444,209	352,791	
報償費	422,000	421,200	800	
旅費	275,000	135,960	139,040	県との共催による講師旅費の減
食糧費	328,000	230,991	97,009	
印刷消耗費	109,000	93,078	15,922	
使用料及び賃借料	663,000	562,980	100,020	県との共催による会場使用料の減
産学・地域間交流事業費	338,000	244,084	93,916	
旅費	53,000	300	52,700	
印刷消耗費	69,000	28,514	40,486	
使用料及び賃借料	216,000	215,270	730	
会員交流会費	403,000	402,182	818	
報償費	50,000	50,000	0	
旅費	6,000	5,550	450	
食糧費	98,000	97,757	243	
印刷消耗費	7,000	6,985	15	
使用料及び賃借料	242,000	241,890	110	
6 事務局経費	16,952,000	15,587,030	1,364,970	
事務局長経費	5,453,000	4,705,052	747,948	
負担金補助及び交付金	5,453,000	4,705,052	747,948	
コーディネーター経費	6,714,000	6,443,368	270,632	
手当等	36,000	27,141	8,859	
共済費	8,000	7,668	332	
報償費	1,870,000	1,679,200	190,800	
負担金補助及び交付金	4,800,000	4,729,359	70,641	
情報提供費	388,000	378,620	9,380	
印刷消耗費	138,000	136,620	1,380	
委託料	250,000	242,000	8,000	
事務局運営費	4,397,000	4,059,990	337,010	
旅費	95,000	82,217	12,783	
食糧費	7,000	7,000	0	
印刷消耗費	376,000	365,915	10,085	
燃料費及び光熱水費	34,000	18,092	15,908	
通信運搬費	102,000	94,945	7,055	
手数料	1,043,000	903,766	139,234	
委託料	635,000	634,809	191	
使用料及び賃借料	987,000	887,379	99,621	
備品購入費	691,000	685,300	5,700	
負担金補助及び交付金	426,000	380,167	45,833	
公課費	1,000	400	600	
当 期 支 出 合 計 (C)	49,923,000	46,962,140	2,960,860	
当 期 収 支 差 額 (B)－(C)	0	2,961,733		